



2026年3月18日

株式会社 FUJI

Fasford Technology 株式会社

FUJI 集团旗下 Fasford Technology 将在 SEMICON China 2026 全球首次公开新世代固晶机 [XERDIA]

株式会社 FUJI (总部: 日本爱知县知立市, 代表取缔役社长: 五十棲 丈二, 以下简称“FUJI”) 旗下从事半导体制造设备开发、制造与销售的集团公司——Fasford Technology 株式会社 (总部: 日本山梨县南阿尔卑斯市, 代表取缔役社长: 栗生 浩之, 以下简称“Fasford Technology”), 将于 **2026年3月25日(周三)至27日(周五)** 在上海举办的 SEMICON China 2026 上, 全球首次公开展示其正在开发的新世代旗舰级固晶机 [XERDIA]。



“固晶机 (Die Bonder)”是一种半导体后道封装设备, 用于将集成电路芯片 (Die) 粘接 (Bonding) 到基板上。

近年来, 随着半导体性能不断提升以及存储容量持续扩大, 将多个芯片以高密度方式进行封装的先进封装技术的重要性不断提高。在此类高密度封装中, 即使是极微小的芯片位置偏差也可能对产品可靠性产生重大影响, 因此, 高精度的固晶技术变得不可或缺。同时, 以生成式 AI 为代表的数据处理需求迅速扩大, 数据量呈爆发式增长, 推动了数据中心及 AI 相关设备的快速普及, 从而带动了以存储器为核心的半导体需求持续增长。因此, 半导体制造工程不仅需要更高精度, 同时也对更高生产效率提出了更高要求。

为满足上述市场需求, Fasford Technology 开发了新一代固晶机 [XERDIA]。

[XERDIA] 在继承传统 DB830 / DB850 系列设计理念的基础上, 对设备机体结构、核心单元以及软硬件控制平台进行了全面革新, 将固晶精度*从 $5\mu\text{m}$ 提升至 $3\mu\text{m}$, 同时将生产效率*从 UPH 4,000 提升至 5,500, 实现了飞跃式性能提升。

此外, 设备还延续了 DB 系列广受好评的操作体验, 在实现高性能的同时, 兼顾了用户友好的操作性。

*根据本公司标准参数设定。

■ 四大开发理念

Fasford Technology 以“**树立新一代量产设备的行业新标准**”为目标，在以下四大开发理念基础上开发了「XERDIA」。

1. 稳定稼动 | 不停机

通过高刚性机体结构将振动降低 50%（与以往机型相比），并采用全新核心单元，使原本广受好评的**稳定稼动率进一步提升**。

2. 缩短生产准备时间 | 省工时

通过新控制平台提升操作性，并导入自动工具更换功能以及工装压持机构的通用化，使换线效率与维护效率**最高提升 34%**。

3. 最大化利用既有设备资产 | 高性价比

最大限度利用 DB 系列既有资产（Tool、Recipe），从而**实现初期投资成本最小化**。

4. 降低环境负荷 | 更加环保

通过提升面积生产率（较以往机型提升 30%）以及新控制平台带来的能效优化，**使设备待机时功耗降低 13%**。同时，通过 ECO 模式 2.0，在**设备空闲状态下可进一步降低 26% 的功耗**，从而减少环境负荷。

■ 加入 FUJI 集团后开发的首款全新机型

「XERDIA」是 Fasford Technology **自 2018 年加入 FUJI 集团以来，首次从零开始开发的全新机型**。设备采用 FUJI Linear 株式会社生产的线性电机，并与 FUJI 设计团队共同完成设备设计，充分体现了 FUJI 集团技术协同效应所带来的全新设计理念。

■ SEMICON China 2026 展示信息

在 2026 年 3 月 25 日（周三）至 27 日（周五）举行的 SEMICON China 2026 展会期间，Fasford Technology 的中国代理商 JIPAL Corporation 将在 N4 馆 4151 展位对开发中的「XERDIA」设备进行参考展示，并将通过展会收集到的市场反馈用于后续产品完善。

此外，FUJI 还将在 E4 馆 4342 展位展示多项自动化解决方案，其中包括用于 SMT 生产工序*的电子元件贴装机器人「NXTR」。

*将电子元器件安装到电路板上的制造工序。

■ 未来规划

上市计划

「XERDIA」预计将于 **2026 年 6 月**正式上市。

Fasford Technology 将通过本次开发进一步强化在先进封装领域的技术实力，创造新的市场价值。同时，公司今后也将持续发挥 FUJI 集团的技术协同优势，为半导体制造领域的技术创新作出贡献。

■公司简介

Fasford Technology 株式会社

公司名称 : Fasford Technology 株式会社
代表人 : 代表取缔役社长 粟生 浩之
总部地址 : 〒400-0212 日本山梨县南阿尔卑斯市下今諏訪 610-5
成立时间 : 2015 年 3 月
业务内容 : 半导体制造设备的设计、制造、销售及维护服务
注册资本 : 4 亿 5050 万日元
网址 : <https://www.fasford-tech.com/cn/>

株式会社 FUJI

公司名称 : 株式会社 FUJI
代表人 : 代表取缔役社长 五十棲 丈二
总部地址 : 〒472-8686 日本爱知县知立市山町茶碓山 19
成立时间 : 1959 年 4 月
业务内容 : 电子元件贴装机器人(贴片机)以及数控机床的研发、制造、销售
注册资本 : 58 亿 7800 万日元
网址 : <https://www.fuji.co.jp/cn/>

■联系方式

Fasford Technology 株式会社

官方网站咨询入口

<https://www.fasford-tech.com/cn/contact/>